

## KLA 為先進半導體封裝新時代推出全面的 IC 載板產品組合

- 全新產品組合通過基板的互連創新提升晶片效能
- KLA 延續了經過市場驗證的 Corus™ 直接成像系統的技術，推出 Serena™ 直接成像平台，以支援主流及高階 IC 載板的光刻需求
- 全新的 Lumina™ 檢測和量測系統進一步為 IC 載板 (包括玻璃基板) 和面板中介層製造商提供有效的高生產品質和良率

加州 MILPITAS，2024 年 10 月 15—今天，KLA Corporation (NASDAQ: KLAC) 推出了業界最全面的 IC 載板(ICS)製程管控和工藝啟用解決方案。KLA 的綜合專業知識佈局在前端半導體、封裝和 IC 載板領域，有助於客戶在針對高階高效能應用的晶片封裝互連密度上取得突破。

*KLA Corporation 現在為 IC 載板製造提供業界最全面的製程控制與製程支援解決方案。隨著 IC 載板和面板中介層等封裝的創新加速，客戶需要新的解決方案，以在支援高效能應用程式的晶片封裝互連密度方面取得突破。*

高階封裝持續採用異構集成方法，將多個半導體元件結合在一起，以提升效能、減低功耗和成本效益。為了滿足不斷變化的互連需求，IC 載板和面板中介層等的封裝水平正在加速增長。這些技術有效的用於連結晶片和印刷電路板(PCB)。隨著封裝尺寸不斷增大、線路尺寸縮小以及採用新型材料(例如玻璃)，製造商可以運用 KLA 的解決方案組合提升良率、加速交付週期以及提升整體盈利能力。

KLA 全面的產品組合包括直接成像(DI)、缺陷檢測、成形、量測、化學製程控制和智慧解決方案，優化了高階封裝製造工作流程。

KLA 的產品組合包括多個直接成像解決方案，支援客戶的各種光刻需求。[Corus™](#) 直接成像平台驗證了其高度靈活、高效成像解決方案方面的能力。為了滿足 IC 載板和下一代高密度互連技術(HDI)等應用不斷發展的需求，新一代光學和雷射技術也在不斷提升，即使針對不同形態的面板也可以快速優化動態成像和層間精度。

針對高階 IC 載板的應用，直接成像打開了 stepper 光刻機領域的全新佈局。KLA 推出全新的 [Serena™](#) 直接成像平台，提升靈活的數位解決方案，用於大尺寸、高層數的有機載板進行高品質和更細緻的線路成像，提升精度與良率。

KLA [Lumina™](#) 針對高階 IC 載板 (包括玻璃基板) 和面板中介層提供全新檢測和量測系統，支援高靈敏度偵測和掃描量測功能，並實現最佳擁有成本。該系統結合人工智能的審查和分類，提供監測，無需操作人員，且與 KLA 的成型解決方案無縫連接。

經過驗證的 KLA 製程管控解決方案，加強了產品組合功能，其中包括 [Orbotech Ultra PerFix™](#)、[EcoNet™](#)、[Zeta™-6xx](#)、[ICOS™ T890](#)、[Quali-Fill® Libra®](#) 和 [QualiLab® Elite](#)。KLA 的 [Frontline](#) 軟件解決方案涵蓋工程、電腦輔助製造 (CAM) 和生產資料資料分析，在 IC 載板製造過程中集中和應用人工智慧，以長期確保 KLA 在良率管理方面的領先地位。

KLA 公司執行副總裁暨策略長 [Oreste Donzella](#) 表示：「通過今天發佈的產品組合，KLA 奠定了在半導體生態系統創新方面的領導地位。」「IC 載板和其他面板級封裝技術對於提升未來高效能晶片的連接能力至關重要，KLA 正在與客戶合作，以解決複雜的生產挑戰，並高度提升他們的良率，為業界奠定成功基礎。」



如需有關 KLA 的全面 IC 載板解決方案組合的更多資訊，請參加即將舉行的 [TPCA 展會](#)。

## 關於 KLA

KLA 公司(簡稱 KLA)提供業界頂尖設備和服務，促進電子行業的創新。我們為製造晶圓和光罩、積成電路、封裝和印刷電路板提供高階製程控制和製程支援解決方案。我們的專家團隊由物理學家、工程師、數據科學家以及問題解決者組成，與全球行業領導者密切合作，設計出推動世界前進的解決方案。投資者和其他人應該注意到，KLA 利用投資者關係網站公佈重大財務資訊，包括美國證券交易委員會的檔案、新聞稿、公開盈利電話和會議網絡直播 ([ir.kla.com](#))。其他資訊，請參閱以下網址：[www.kla.com](#)

## 前瞻性論述

本新聞稿中的陳述，除歷史事實外，其他如 IC 載板產品組合預期效能的聲明，均為前瞻性論述，且受 1995 年《私人證券訴訟改革法》所設的安全港條款約束。這些前瞻性論述基於目前資訊和預期推估，涉及風險和不確定因素。由於眾多因素，包括採用新技術時延遲 (無論是因成本、效能問題還是其他原因)，其他公司推出競爭產品、遭遇意料之外的技術挑戰或限制而影響 KLA 產品的採用、效能或使用，以及 KLA 截至 2024 年 6 月 30 日財務年度的 10-K 年報中所列的其他風險因素，及 KLA 向美國證券交易委員會申報的其他文件 (包括但不限於其中所述的風險因素)，實際結果可能與該等論述的預測有重大差異。KLA 沒有義務且目前也不打算更新這些前瞻性陳述。

投資者關係：投資者關係副總裁 Kevin Kessel [kevin.kessel@kla.com](mailto:kevin.kessel@kla.com)

媒體關係：公司營銷傳播部 Mike Dulin [michael.dulin@kla.com](mailto:michael.dulin@kla.com)

+++++